

Petek, 19. december 2025

Pozdravljeni s strani ekipe Kompetenčnega centra za čipe KC Čip.si!

Pošiljamo vam tedenski pregled izbranih informacij in novosti s področja čipov, polprevodnikov ter aktivnosti KC Čip.si.

Aktualno:

- **4. Slovenska konferenca o čipih in polprevodnikih (SLO-chip 2026)**, 22. januar 2026, Ljubljana. Konferenco organizirata KC Čip.si in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. **Vabljeni k udeležbi in oddaji prispevkov!**
<https://slo-chip.fe.uni-lj.si/>
V okviru konference poteka tudi **tekmovanje magistrskih nalog** s področja čipov in polprevodnikov. **Vabljeni k sodelovanju!** <https://slo-chip.fe.uni-lj.si/competition25.pdf>
- **Javno povabilo MGTŠ za izkaz interesa in predložitve osnovnih projektnih predlogov za vključitev slovenskih podjetij v projekt skupnega evropskega interesa na področju naprednih polprevodniških tehnologij (IPCEI Advanced Semiconductor Technologies).**
<https://www.gov.si/novice/2025-12-15-moznost-sodelovanja-v-evropskem-projektu-na-podrocju-naprednih-polprevodniskih-tehnologij/>
- Odprte so prijave za **ECS Brokerage event 2026** dogodek, 4.-5. Feb 2026, The EGG, Bruselj.
<https://ecs-brokerage-event.eu/>
Dogodek združuje skupnost ECS (Electronic Components and Systems) z namenom mreženje, vzpostavljenja konzorcijev in ustvarjanja novih projektnih idej ter predlogov.

Ostale novice :

- **Preboj na naslednji generaciji 3D-sekvenčne integracije čipov (3DSI) — 10. 12. 2025.**
FAMES Pilot Line (CEA-Leti) je uspelo razviti proces izdelave popolnoma funkcionalno 2,5 V SOIC CMOS vezja pri zgolj 400°C (prej 1000°C). Nov process izdelave omogoča zanesljivo realizacijo 3D zaporedne integracije čipov, ki je ključna za t.i. "More-than-Moore" integrirane sisteme novih generacij.
[CEA/Recherche et innovation](https://cea-recherche-et-innovation.com/en/3dsi-3d-sequential-integration-breakthrough)

- **Spodbude za razvoj in proizvodnjo strateških tehnologij za Evropo - JR STEP.**
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za javni razpis
<https://www.gov.si/novice/2025-12-17-evropska-sredstva-za-strateske-tehnologije-odobren-javni-razpis-step/>
- Odprto je **javno posvetovanje Evropske komisije za Akt o naprednih materialih.**
Posvetovanje je odprto do: **13. januarja 2026**
<https://een.si/odprto-je-javno-posvetovanje-evropske-komisije-za-akt-o-naprednih-materialih/>
- Tekmovanje: **PHOTONICS21 INNOVATION AWARD 2026**
Evropska tehnološka platforma Photonics21 organizira tekmovanje »Photonics21 Innovation Award 2026«. Organizator vabi študente, podjetnike in ustvarjalce z idejo za fotonski izdelek, ki ima možnost postati uspešna poslovna zgodba. Rok za prijavo: **2. april 2026.**
<https://www.photonics21.org/2025/apply-now%21-photonics21-innovation-award-2026-launched>



Slovenski kompetenčni center za čipe in polprevodniške tehnologije

KC Čip.si - glavna pisarna

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Tržaška cesta 25, Ljubljana

E-pošta: office@cc-chip.si

Tel.: 01 476 88 50

Spletna stran (v izdelavi): <https://cc-chip.si/>



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

Projekt CC Chip.si (št. 101217674) je sofinanciran s strani Chips Joint Undertaking in Evropske unije v okviru programa Digital Europe.

To sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavljene na prejemanje novic KC Čip.si ali izrazili interes za obveščanje o naših dejavnostih.

Če novic ne želite več prejemati, se lahko kadarkoli odjavite.

[Odjava](#)

